

國立政治大學 函

機關地址：臺北市文山區指南路二段64號

機關傳真：29387749

承辦人：陳瑞英

聯絡電話：02-29393091#66899

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國106年12月14日

發文字號：政研發字第1060037461號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：科技部函、計畫徵求公告、附件1業界合作意願書、附件2規劃與法人單位合作之工作項目與內容說明、附件3矽光子及積體電路專案研究計畫、附件4核心技術之成果指標說明表

主旨：科技部公開徵求「矽光子及積體電路」專案研究計畫，自即日起受理申請，校內線上截止收件時間107年3月8日(星期四)下午5時止，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依106年12月12日科部工字第1061011848號函辦理。
- 二、本專案計畫擬整合學界研發能量與資源、國研院晶片中心(CIC)的多計畫晶片(MPW)服務、國家奈米元件實驗室(NDL)的客製化製程服務、工研院的量測平台與封裝服務及晶圓廠的製程服務，研究發展以矽光子積體電路技術為基礎的系統應用光電晶片。
- 三、本案以達成技術實用性及具產業應用潛力為主要目標，規劃四年期計畫，前二年完成核心技術開發與系統晶片架構設計，第三年完成系統晶片製作與性能優化，第四年完成系統展示並能將技術與廠商進行後續之應用與推廣。本計畫需要有法人單位與產業界參與實質合作，尤其是光電晶片設計公司或光電系統應用公司，以提高產業效益。
- 四、計畫申請重點提醒：
 - (一) 以單一整合型計畫為限，計畫書總計畫及所有子計畫全部書寫於一份計畫書，每一整合型計畫需含總計畫與至少3項子計畫，總計畫主持人須同時主持1項子計畫。
 - (二) 計畫全程期限為四年(107年8月1日至111年7月31日止)，計畫核定

採分年核定多年期計畫。計畫每年度申請總額度以不超過2,500萬元為原則。

(三) 本專案計畫期以落實產學研密切結合之目標，故計畫團隊須邀請業界及法人單位參與規劃及執行，並於申請計畫時提供附件1(業界合作意願書及合作內容說明)及附件2(法人單位合作內容說明);另計畫書中須規劃研究項目及應用項目，且須針對各項核心技術，說明目前及計畫預定達成之技術成熟度(如附件3)及成果指標說明(如附件4);並請將附件1-4置於計畫書表CM03研究計畫內容最後。

(四) 有意申請者，請至科技部專題研究計畫線上提出申請，計畫類別請勾選「一般型研究計畫」、研究型別請勾選「整合型計畫」、計畫歸屬請勾選「工程司」、學門代碼請勾選E9854「矽光子及積體電路」專案研究計畫。線上完成申請，並請所屬單位於同年3月9日(星期五)中午12時前將申請名冊送達研發處，俾利函送科技部提出申請。

五、本專案計畫相關申請規範與研究範疇等細節說明，請詳閱科技部網站-動態資訊(計畫徵求)或工程司網站-公告事項下載參閱。

六、計畫申請如有疑慮，請洽科技部張庭軒先生，電話:(02)2737-7437。線上申請系統操作問題，請洽科技部資訊系統服務專線：0800-212-058、(02)2737-7590-92。

正本：本校各院、所、系、中心

副本：研究發展處

校長 周 行 一